

Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from, Europe, America and south Asia, supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of "Quality Parts, Customers Priority, Honest Operation, and Considerate Service", our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip, ALPS, ROHM, Xilinx, Pulse, ON, Everlight and Freescale. Main products comprise IC, Modules, Potentiometer, IC Socket, Relay, Connector. Our parts cover such applications as commercial, industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China











LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【1.適用範囲 SCOPE】

 本仕様書は、
 <u>殿</u> に納入する

0.5mm ピッチ FFC 対 基板 用 コネクタ について規定する。

This specification covers the 0.5mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR series

【 2 . 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製 品 名 称 Product Name		製 品 型 番 Material Number
ハウジングアッセンブリ Housing Assembly (RA Type)	無鉛 LEAD FREE	501864-**11
501864-**11 テーピング梱包 Embossed Tape Package for 501864-**11	無鉛 LEAD FREE	501864-**90
プラグジャケット Plug Jacket	無鉛 LEAD FREE	501783-**09
プラグジャケットカバー Plug Jacket Cover	無鉛 LEAD FREE	501784-**09

*: 図面参照 Refer to the drawings.

【3.定格 RATINGS】

項 目 Item	規 Stan	格 dard
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	50 V ^{*2}	[AC (字效/
最大許容電流 Rated Current (MAX.)	0.5 A ⁻²	[AC (実効値 rms) /DC]
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	-40℃ ~	+85°C*1*2

*1:通電による温度上昇分を含む。

Including terminal temperature rise.

*2:使用FFCも本定格を満足すること。

FFC must be met ratings specified in this standard.

	REV.	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α				
	SHEET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		REVI	SE OI	N PC	ONLY	,		TITLE												
				新規(RELEA				1111		mm F	PITCH	H FF(СТО	воа	RD C	ONN	IECTO	OR		
	A		J	2006-	-1206							-LE	AD I	FREE	-		製品	品仕	羡書	
			'05/1	0/20	H.IIJ	IIVIA		_				_	_	_		_	OPRIE		-	
	REV.		DE	SCRI	<u>IPTIO</u>	N		MOLE	X INC.	AND S	HOUL	O NOT	BE US	ED WI	THOUT WRITTEN PERMISSION					
	DESIG	GN C	ONTF	ROL	S	TATU	JS	WRIT B\		CH	IECKE BY:	D	APPR(B)			DATE	: YR/N	10/D <i>A</i>	·Υ	
		J						H.IIJ		K.TA	KAHA	SHI	H.HIF			200	05/10	/20		
DOC	DOCUMENT NUMBER								•				FI	ILE N	AME	5	SHEE	Γ		
	PS-501864-001												PS5	018640	001.doc	: 1	OF 1	5		
																E١	1-37(0	19)		





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【4.性 能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	適合FFCハーネスを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、 短絡電流 10mA 以下 にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate applicable FFC Harness, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	40 milliohm MAX.
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	適合FFCハーネスを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate applicable FFC Harness and apply 500V DC between adjacent terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	50 Megohm MIN.
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	適合FFCハーネスを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC 250V (実効値)を 1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate applicable FFC Harness, apply 250V AC (rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-2-1	挿入・抜去力 Insertion Force/ Withdrawal Force	ロックを解除した状態にて、毎分 25± 3 mm の速さで挿入・抜去を行う。 Insert and withdraw connectors, at the speed rate of 25± 3 mm per minute.	第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-1	強制抜去力 Compulsion Withdrawal Force	適合FFCハーネスを嵌合させ、ロックを解除せずに毎分 25± 3 mm の速さで軸方向にを引き抜く。 Mate applicable FFC Harness, apply axial pull out force at the speed rate of 25± 3 mm per minute.	9.8 N{ 1.0 kgf} MINIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	3
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	ET 1 OF 10 -LEAD FREE-	- 製品	仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOC	UMENT N	NUMBER S-501864-001		FILE NAME	SHEET
	- '			PS501864001.doc	2 OF 15 7-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4-3.その他 Environmental Performance and Others

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Requ	格 uirement
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Mate / Un-matel	無通電状態にて、1分間 に 10回以下 の速さで挿入、抜去を 20回 繰り返す。 When mated up to 20 cycles repeatedly at the speed rate of less than 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	適合FFCハーネスを嵌合させ、最大許容電流を 通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAX.
		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 3方向 に掃引割合 10~55~10Hz/分、	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-3	耐 振 動 性 Vibration	全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。 (MIL-STD-202試験法 201) Amplitude : 1.5 mm P-P Sweep time: 10-55-10 Hz in 1 minutes	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
		Duration : 2 hours in each X.Y.Z axes (MIL-STD-202, Method 201)	瞬 断 Discontinuity	1 microsecond MAX
		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 6方向 に 490m/s ² {50G} の衝撃を	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-4	耐衝擊性 Shock	各3回 加える。 (JIS C041 / MIL-STD-202試験法 213)	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
		490m/s ² {50 G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C0041/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	1 microsecond MAX.
4-3-5	耐 熱 性	適合FFCハーネスを嵌合させ、85± 2℃ の 雰囲気中に96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-0-0	Heat Resistance	(JIS C0021/MIL-STD-202 試験法 108) 85± 2°C, 96 hours (JIS C0021/MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
			0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	3
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	- 製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		-
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT I			FILE NAME	SHEET
	P;	S-501864-001		PS501864001.doc	3 OF 15
		·		FN-3	7-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 Req	格 uirement
4-3-6	耐 寒 性 Cold			異状なきこと No Damage
4-3-0	Resistance	(JIS C0020) -40± 2°C, 96 hours (JIS C0020)	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
		適合FFCハーネスを嵌合させ、60± 2℃ 相対	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-7	耐湿性	湿度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後 取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0022/MIL-STD-202 試験方法103)	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
4-3-7	Humidity	Temperature: 60± 2°C Relative Humidity: 90 ~ 95% Duration: 500 hours	耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3
		(JIS C0022/MIL-STD-202 Method 103)	絶縁抵抗 Insulation Resistance	20 Megohm MIN.
4-3-8	適合FFCハーネスを嵌合させ、-55± 3°Cに30分、 +85± 2°C に 30分、これを 1サイクル とし、 5サイクル 繰り返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後 1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0025) 5 cycles of: a) -55± 3°C 30minutes b) +85± 2°C 30minutes (JIS C0025)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage	
4-3-6		Cycling (JIS C0025) 5 cycles of : a) -55± 3°C 30minutes b) +85± 2°C 30minutes		60 milliohm MAX.
4-3-9	塩水噴霧	適合FFCハーネスを嵌合させ、35±2℃ にて 重量比5±1% の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験 後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C0023/MIL-STD-202 試験方法101)	外 観 Appearance	割れ、著しい 腐食等 異状なきこと No Damage
	Salt Spray	1 (JIO CUUZO/IVIIL-O I D-ZUZ muiak / I/A IU I /		60 milliohm MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	٦
SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	- 製品	仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOC	1			FILE NAME	SHEET
	PS-501864-001			PS501864001.doc	4 OF 15
			•	EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Req	格 uirement
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	適合FFCハーネスを嵌合させ、40± 2℃ にて 50± 5ppmの亜硫酸ガス中に 24時間放置する。 24 hours exposure to 50± 5ppm. SO ₂ gas at 40± 2℃	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
4-3-11	耐アンモニア性 NH ₃ Gas	適合FFCハーネスを嵌合させ、濃度 28% のアンモニア水を入れた容器中に 40分間 放置する。 (1Lに対して25mLの割合) 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution.	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAX.
4-3-12	半田付け性 Solder Ability	端子先端より 0.3mm、金具先端より 0.3mm の位置まで、245± 3℃ の半田に 3± 0.5秒 浸 す。 Soldering Time: 3± 0.5 seconds Solder Temperature: 245± 3℃ 0.3mm from terminal tip. 0.3mm from fitting nail tip.	濡 れ 性 Solder Wetting	浸漬面積の 75%以上 75% of immersed area must show no voids, pin holes.
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	(リフロー時) 第7項参照。 (When reflowing) Refer to paragraph 7. (手半田) 端子先端より 0.3mm、金具先端より 0.3mm の位置まで 350± 10℃ の半田ゴテにて 3秒 加熱する。 (Soldering iron method) Solder time: 3 seconds Solder temperature: 350± 10℃ 0.3mm from terminal tip. 0.3mm from fitting nail tip.	外 観 Appearance	端子ガタ、 割れ等 異状無き事 No Damage

(): 参考規格 Reference Standard { }: 参考単位 Reference Unit

【 5 . 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	3
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		-
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N			FILE NAME	SHEET
	P	S-501864-001		PS501864001.doc	5 OF 15
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE JAPANESE

ENGLISH

【 6 . 挿入・抜去力 INSERTION FORCE/WITHDRAWAL FORCE】

下記のFFCを使用した場合のテストデータ (参考) This test data in case of used the following FFC(Reference)

FFC : 住友電気工業株式会社 製

FFC: SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.

厚さ(導体部): 0.3 mm

Thickness (CONDUCTOR AREA): 0.3 mm

(N=5)

						(11-0)		
極数	of		挿入力 Retention Force			抜去力 Withdrawal Force		
No.	CKT	UNIT	平均値 AVG.	最大値 MAX.	最小値 MIN.	平均値 AVG.	最大値 MAX.	最小値 MIN.
	初回	N	13.80	14.3	12.7	10.18	11.1	9.2
	1st	{kgf}	{1.41}	{1.46}	{1.30}	{1.04}	{1.32}	{0.94}
40	10回目	N	13.20	13.7	12.7	9.43	10.4	8.5
	10th	{kgf}	{1.35}	{1.40}	{1.30}	{0.96}	{1.03}	{0.87}
	20回目	N	13.05	13.3	12.8	9.78	10.4	9.4
	20th	{kgf}	{1.33}	{1.36}	{1.31}	{1.00}	{1.06}	{0.96}
	初回	N	15.66	17.5	13.4	13.34	14.2	12.5
	1st	{kgf}	{1.60}	{1.79}	{1.37}	{1.36}	{1.45}	{1.28}
50	10回目	N	13.96	15.5	12.8	12.28	13.3	11.7
	10th	{kgf}	{1.42}	{1.58}	{1.31}	{1.25}	{1.36}	{1.19}
	20回目	N	14.28	15.9	13.5	12.7	13.8	12.1
	20th	{kgf}	{1.46}	{1.62}	{1.38}	{1.30}	{1.41}	{1.23}
	初回	N	23.62	24.3	23.0	18.24	19.3	16.9
	1st	{kgf}	{2.41}	{2.48}	{2.35}	{1.86}	{1.97}	{1.72}
80	10回目 10th	N {kgf}	20.14 {2.06}	20.9 {2.13}	19.0 {1.94}	14.66 {1.50}	15.2 {1.55}	14.1 {1.44}
	20回目 20th	N {kgf}	20.90 {2.13}	21.4 {2.18}	20.0 {2.04}	15.06 {1.54}	15.3 {1.56}	14.7 {1.50}

^{*40,50}極は80極データからの想定値となります。

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE-	製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		-
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501864-001		5-501864-001		PS501864001.doc	6 OF 15
				EN-3	7-1(019)

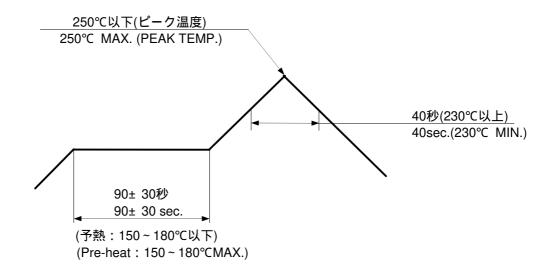




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【 7 . 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION 】



温度条件グラフ (温度は基板パターン面)

TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記; 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、

事前にリフロー評価の確認をお願い致します。

NOTE; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand.

Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.

	l	REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	3
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501864-001		5-501864-001		PS501864001.doc	7 OF 15
				EN-3	7-1(019)



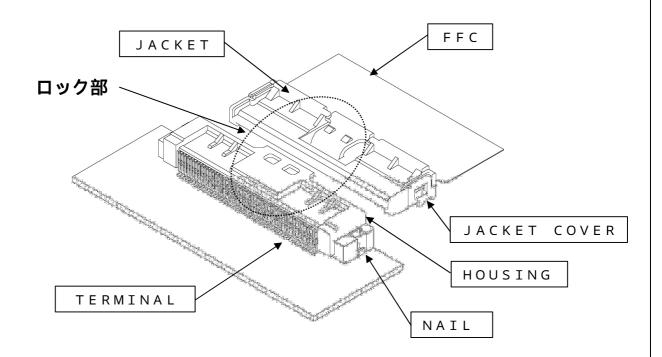


LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【8.取り扱い説明書 INSTRUCTION FOR THE HANDLING OF THE CONNECTOR】

8-1. 各部の名称 DESCRIPTION OF EACH PART



8-2. 基板への実装に関して MOUNTING ON THE PC BOARD

基板への実装は実装機にて実施願います。もし、手半田する場合は、TERMINAL及びNAIL等に触れない様に願います。(半田付け不良等の原因となる可能性が有ります。)

The mounting of the PC board is handled by the mounter. If to manually solder, please be cautious to not touch the Terminal and Fitting Nail.(It will create the possibility to cause solderbility failure.)

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501864-001		5-501864-001		PS501864001.doc	8 OF 15
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

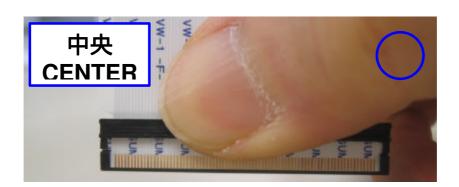
JAPANESE ENGLISH

8-3.コネクタ嵌合に関して MATING THE CONNECTOR

コネクタを嵌合する際は、JACKETとJACKET COVERの全体もしくは中央を掴んで挿入を実施ください。

When mating the connector, hold the JACKET AND JACKET COVER together at either a whole or the center portion of them to insert.





		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
	A	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	- 製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501864-001		5-501864-001		PS501864001.doc	9 OF 15
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

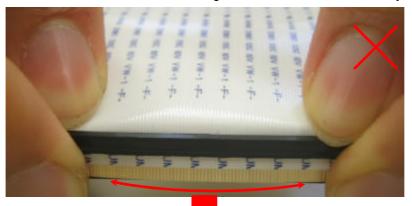
JAPANESE ENGLISH

以下のような嵌合は回復不可能な機能不全や製品破壊につながりますので実施しないで下さい。 The following method of mating will cause either irreversable functionality failure or product breaking, so please do not mate this way.

・FFCのみを掴まないでください。 Please do not hold the FFC part only



・JACKETとJACKET COVERの 端部のみを掴まないでください。 Please do not hold the JACKET AND edge of the JACKET COVER only





		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	3
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	- 製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		_
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501864-001		5-501864-001		PS501864001.doc	10 OF 15
			<u> </u>	EN-3	7-1(019)

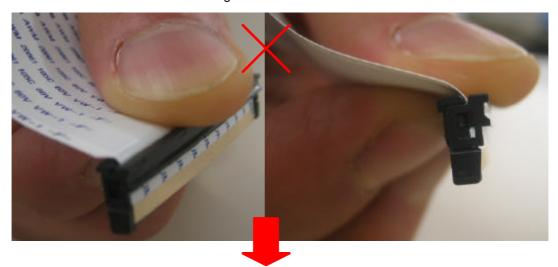




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

・FFCを折り曲げるように掴まないでください。 Please do not hold the FFC like bending it.





		REVISE ON PC ONLY	TITLE:				
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOAF	RD CONNECTOR	٦		
	Α	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	製品	仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	DOCUMENT NUMBER PS-501864-001			FILE NAME	SHEET		
1 0 001001 001				PS501864001.doc FN-3	11 OF 15 7-1(019)		





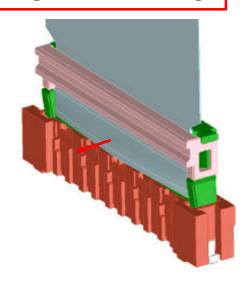
LANGUAGE

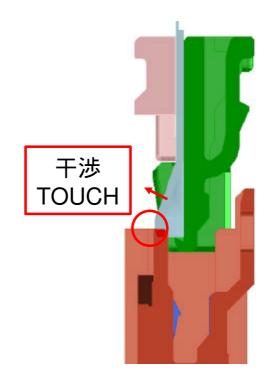
JAPANESE ENGLISH

- ※ FFCが極端に浮くと、嵌合時にHOUSINGと干渉し座屈する可能性があります。
 - * If FFC warps too much, it will touch with the Header housing when mated,

andmay possibly cause buckling.

FFCの極端な浮き TO WARPED FFC

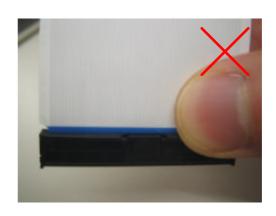




・JACKETとJACKET COVERの片端のみを掴まないでください。 斜め嵌合となり、不良につながります。

Please do not hold one side of the JACKET and the JACKET COVER only as shown below. It will be mated in the slant direction and will cause failure





		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
	A REV.	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE-	製品	仕様書
		DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOC	DOCUMENT NUMBER PS-501864-001			FILE NAME	SHEET
				PS501864001.doc	12 OF 15
				EN-3	7-1(019)



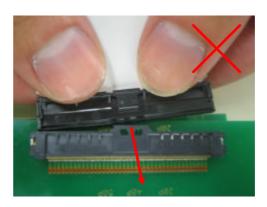


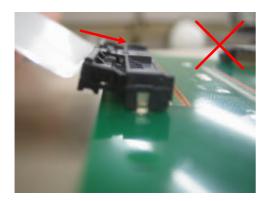
LANGUAGE

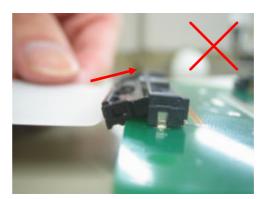
JAPANESE ENGLISH

・斜め嵌合は不良につながりますので実施しないでください。 Mating inconsistently will cause failure, so please do not do this.









・嵌合状態 及び 嵌合時のFFC引き回し作業においてロック部に無理な負荷が掛かるような 使用は避けてください。

Please be cautious not to put excess load at the lock part after mating and when FFC is pulled and extracted.

		REVISE ON PC ONLY	- TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
	A	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	- 製品	仕様書
	DEV	DECODIDATION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. 7 IND GITGGED INCT DE GOLD INT		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
	P	S-501864-001		PS501864001.doc	13 OF 15
			•	FN-3	7-1/019)

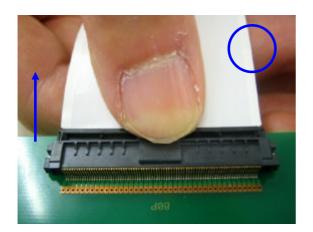


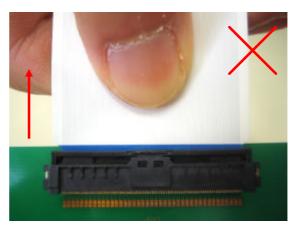


LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

コネクタの嵌合を取り外す際は、必ずロック解除して実施ください。 Please be sure to release the lock when unmating the connector.





以上

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	A		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
		SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE	製品	仕様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		_
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501864-001		5-501864-001		PS501864001.doc	14 OF 15
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
А	RELEASED	'05/10/20	J2006-1206	H.IIJIMA	K.TAKAHASHI

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	_		0.5 mm PITCH FFC TO BOARD CONNECTOR		
	A	SEE SHEET 1 OF 10	-LEAD FREE-	製品	仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOCUMENT NUMBER PS-501864-001				FILE NAME PS501864001.doc	SHEET
					7-1(019)